

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2021-020

广东正业科技股份有限公司
关于与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签订
战略合作备忘录的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签署的是合作备忘录，本备忘录系为加强双方战略合作而订立的框架性文件，所载事项是达成的初步意向，不构成对各方具有法律约束力，仅作为各方商洽的依据。待条件成熟时，各方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。具体的实施内容和进度存在不确定性，尚需进一步落实和明确，根据后续进展情况，公司将依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。本协议的后续履行尚存不确定性。

2、本备忘录的签署对公司本年度及后续年度的业绩及经营成果的影响尚不确定，敬请投资者注意投资风险。

一、备忘录签署概况

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）与株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）于2021年4月2日签订了《战略合作备忘录》。本次备忘录的签订无需提交公司董事会和股东大会审议，公司将根据后续进展情况，依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。现将具体情况公告如下：

二、合作对方介绍

1、企业名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

2、统一社会信用代码：914302007121360371

3、成立时间：1998 年 9 月 22 日

4、法定代表人：李葵

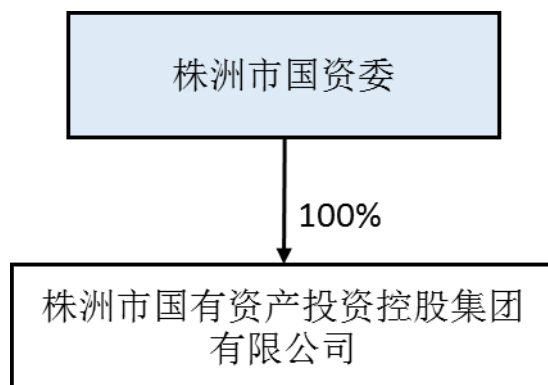
5、注册资本：400000 万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（国有独资）

7、注册地：株洲市天元区神农城森林路 268 号

8、经营范围：国有资产投资、经营；对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务（不得从事吸收存款、集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；与主营业务相关的配套产业经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权控制结构如下：



10、关联关系说明：截止本公告披露日，合作方与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。

三、备忘录的主要内容

甲方：株洲市国有资产投资控股集团有限公司

乙方：广东正业科技股份有限公司

株洲作为中部地区长株潭城市群的重要一极、中国功率半导体产业制造基地，拥有以集成电路产业链为核心的电子信息产业体系，在新型电子元件、高端

功率器件、先进传感器、关键电子材料四大领域汇聚行业领军企业，电子信息产业基础雄厚，产业链协同优势明显。

株洲市国有资产投资控股集团有限公司是株洲市国资委下属的国资单位，作为株洲市“产业发展商”，聚焦电子信息、高端装备制造、轨道交通等高科技产业投资，为支持株洲市集成电路产业发展与招商引资要求，在半导体芯片设计、晶圆制造、封测等产业链关节积极开展投资布局，大力促进集成电路及相关高端装备制造产业在株洲区域实现快速发展。

广东正业科技股份有限公司是深圳证券交易所创业板上市公司（股票代码：300410），作为行业领先的工业检测智能装备提供商，主要以“光学检测和自动化控制技术”为核心，向 PCB、锂电、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等产品，主要涵盖电子信息及新能源汽车两大领域，均为株洲市重点发展的战略新兴支柱产业，契合株洲市的中长期产业发展规划。

甲、乙方希望通力合作，依托株洲市区位优势及产业基础，充分发挥各自优势，共同建设“半导体无损检测智能装备产业化项目和基于动力锂电池用叠片工艺的智能装备产业化项目”（“项目”），整合业内优秀的科研和销售团队，打造国家中部地区高端智能装备产业化示范高地。经各方协商一致，现就有关项目推进事宜达成如下约定：

1、项目内容

1.1 投资规模。项目总投资额为 10 亿元人民币，分期进行。其中，项目一期（“项目一期”）投资规模 6 亿人民币。

1.2 项目产品。项目一期为半导体无损检测智能装备产业化建设项目，面向半导体芯片领域研发生产销售半导体 X 光无损检测机，通过 X 射线的强穿透性进行透视成像揭示受照芯片内部的结构或形态，解决半导体芯片各种缺陷检测问题，提升芯片良率。

1.3 投资安排。项目一期公司（“项目公司”）注册资本金拟为 2 亿元人民币，乙方拟以直投方式对项目公司出资，投资金额为 2 亿元人民币，占项目公司

注册资本的比例为 100%。注册资本金来源主要为乙方自有资金以及乙方自筹资金如银行贷款等，分期到位。

1.4 厂房建设。项目公司拟需求约 50 亩工业用地用于建设厂房和配套生活设施。

2、主要措施

2.1 甲方职责

2.1.1 土地提供。甲方依法依规协调地方政府提供工业用地净地面积约 50 亩，并根据乙方需求协调提供后续用地。

2.1.2 优惠政策。甲方协调地方政府为项目匹配相关优惠政策，包括但不限于高新企业补贴、固定资产补贴、研发补贴等，积极为项目适用国家、湖南省、株洲市的各类相关优惠政策创造有利条件。

2.1.3 人才支持。甲方协调地方政府提供专项人才引进奖励一揽子政策，包括但不限于人才激励政策、安家补贴、购房补贴、子女上学指标等。

2.1.4 税收优惠。甲方负责协调为项目公司提供税费减免优惠政策。

2.2 乙方职责

2.2.1 产值达成。在甲方、乙方履行协议约定的前提下，公司及管理团队承诺按时完成项目投资总额及后期商定的预期产值。

2.2.2 项目启动。本备忘录签署后，公司管理团队立即启动项目规划论证（可行性）筹建工作，组织前期人员进入现场办公，开展项目公司注册、项目建设计划和筹划具体实施方案，确保项目按时开工建设，按期竣工投产，甲方有权向项目公司委派管理层人员参与公司管理运营。

3、其他事项

3.1 非约束性。本备忘录系为加强双方战略合作而订立的框架性文件，所载事项是达成的初步意向，不构成对各方具有法律约束力，仅作为各方商洽的依据。待条件成熟时，各方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。

3.2 保密义务。各方承诺，对合作过程中互相知晓或者获得的对方资料、国家秘密、商业秘密等信息负有严格的保密义务，未经对方书面许可，不得披露给任何第三方，但是法规法规或规章规定的除外。

3.3 对外宣传。双方开展战略合作的对外宣传有关内容，应经各方共同书面同意后发布。

3.4 条款补充。本备忘录未尽事宜，各方可另行协商签订补充协议。如遇法律法规或者政策调整，应当对本备忘录相关内容进行调整或变更。

四、本次合作对公司的影响及风险提示

1、本次签署的是合作备忘录，本备忘录系为加强双方战略合作而订立的框架性文件，所载事项是达成的初步意向，不构成对各方具有法律约束力，仅作为各方商洽的依据。待条件成熟时，各方将协商拟定具体投资方案并签订正式协议。具体的实施内容和进度存在不确定性，尚需进一步落实和明确，根据后续进展情况，公司将依据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。本协议的后续履行尚存不确定性。敬请投资者注意投资风险。

2、本次投资建设项目符合公司的“工业检测智能装备”发展战略，如顺利实施，对公司半导体检测和锂电业务的发展具有积极的推动作用，有利于公司依托株洲市区位优势及产业基础，加快推进“半导体无损检测智能装备产业化项目和基于动力锂电池用叠片工艺的智能装备产业化项目”的产业化和市场化，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

3、本备忘录的签署对公司本年度及后续年度的业绩及经营成果的影响尚不确定。

五、其他说明

1、截至本公告披露日，公司最近三年内签署的框架协议情况：

序号	公告名称	披露日期	进展情况
----	------	------	------

1	关于与真爱集团签订战略合作协议的公告（公告编号：2019-071）	2019 年 6 月 25 日	真爱集团目前正处于厂房基建阶段，待厂房完工后，将根据项目进展逐步实施。
2	关于与深南电路签订战略合作协议的公告（公告编号：2019-063）	2019 年 6 月 19 日	正常履行
3	关于与工商银行东莞分行签订战略合作协议的公告（公告编号：2018-178）	2018 年 11 月 28 日	前期合同已履行完毕，目前暂无合作。
4	关于签订战略合作协议的公告（公告编号：2018-106）	2018 年 7 月 13 日	因市场发展变化，不具备合作基础，已终止。
5	关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的公告（公告编号：2018-074）	2018 年 5 月 25 日	前期合同已履行完毕，目前暂无合作。

2、本次战略合作备忘录签订前三个月内公司控股股东、董监高所持股份未发生变化；截至本公告披露之日，公司未收到控股股东、董监高减持公司股份的计划。

六、备查文件

1、双方签订的《战略合作备忘录》。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日